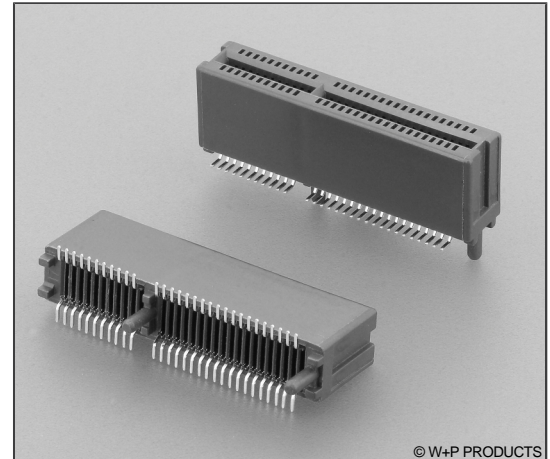


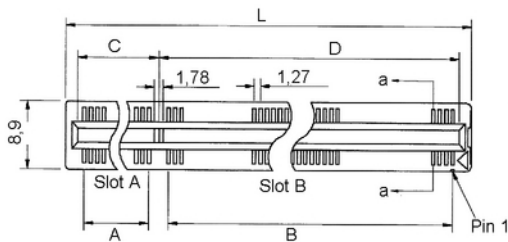
SMT Card Edge Verbinder RM 1,27mm, stehend – Double Slot Version SMT Card Edge Connectors, 1.27mm Pitch, Vertical – Double Slot Version

Technische Daten / Technical Data

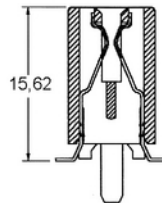
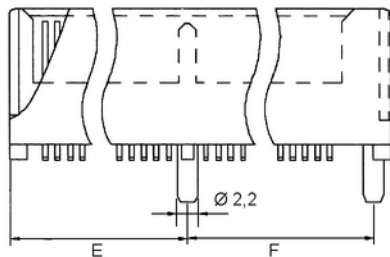
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Farbe <i>Colour</i>	Schwarz <i>Black</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Im Kontaktbereich vergoldet / Lötseite verzinkt (über Ni) (andere Veredelungen auf Anfrage) <i>Au plated contact area / Sn plated solder area (over Ni)</i> <i>(More plating options on request)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	125V _{AC} max.
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +105°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>
Mechanische Haltbarkeit <i>Mechanical Durability</i>	Min. 100 Steckzyklen <i>Min. 100 mating cycles</i>



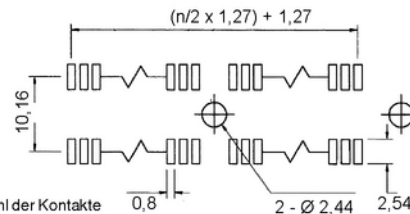
Empfohlene Steckkartendicke:
1,60mm+/-0,30
Recommended PCB thickness:
1.60mm+/-0.30



		Dimensions (mm)							
Contacts		040	050	060	080	100	112	120	182
Slot A / Slot B		22 / 18	22 / 28	22 / 38	22 / 58	22 / 78	22 / 90	22 / 98	84 / 98
A		12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	52,07
B		10,16	16,51	22,86	35,56	48,26	50,88	60,96	60,96
C		15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	55,25
D		13,34	19,69	26,04	38,74	51,44	59,06	64,14	64,14
E		18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	57,66
F		13,97	20,32	26,67	39,37	52,07	59,69	64,77	64,77
L		34,04	40,39	46,74	59,44	72,14	79,76	84,84	124,21



Section a - a



PCB - LAYOUT

Series

1221

Contacts*

112

040 050 060 080 100
112 VESA
120 PCI 32bit
182

Plating

60

60 Sel. Au/Sn (Standard)
Andere Veredelungen auf Anfrage.
Duplex plating (Standard)
More plating options on request.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

